

PK223

Thermal Conductive Gel Pad

LiPOLY PK223 は熱伝導率2.0 W/m*Kの隙間充填材です。硬さはShore OO/30で、高柔軟性、高絶縁耐圧、粘着性が良く、機構の設計公差は補ます。安定性が高いので、形は標準サイズからオーダーメイドフォーミング形までも対応できます。

■ 製品の特性

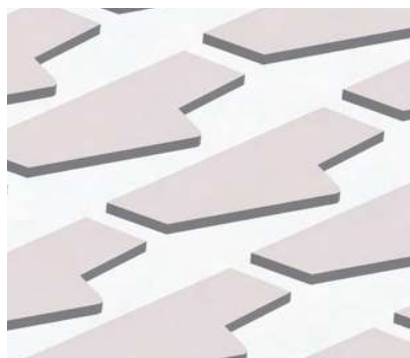
- / 熱伝導率: 2.0 W/m*K
- / 表面には自粘性があって、作業しやすい
- / 熱抵抗性低い
- / 色んな厚さは選べます

■ 製品アプリケーション

- / ノートパソコン
- / ヒートパイプモジュール
- / メモリモジュール
- / TV ハードデバイス
- / 自動車電気装置
- / モバイルデータ通信
- / 高速記憶装置
- / セットトップボックス
- / ネットワークカメラ
- / 5Gの基地局(基幹施設/設備)
- / 電気自動車

■ 製品の形

- / ロール状 / シート状
- / フォーミング形



■ TYPICAL PROPERTIES

PROPERTY	PK223	TEST METHOD	UNIT
Color	White	Visual	-
Surface tack 2-side/1-side	2	-	-
Thickness	Customized	ASTM D374	mm
Density	2.1	ASTM D792	g/cm ³
Hardness	30	ASTM D2240	Shore OO
Application temperature	-60~180	-	°C
ROHS & REACH	Compliant	-	-
COMPRESSION@1.0mm			
Deflection @10 psi	33	ASTM D5470 modify	%
Deflection @20 psi	38	ASTM D5470 modify	%
Deflection @30 psi	42	ASTM D5470 modify	%
Deflection @40 psi	45	ASTM D5470 modify	%
Deflection @50 psi	48	ASTM D5470 modify	%
ELECTRICAL			
Dielectric breakdown	11	ASTM D149	KV/mm
Surface resistivity	>10 ¹⁰	ASTM D257	Ohm
Volume resistivity	>10 ¹⁰	ASTM D257	Ohm-m
THERMAL			
Thermal Conductivity	2.0	ASTM D5470	W/m*K
Thermal impedance@10 psi	0.711	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@20 psi	0.664	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@30 psi	0.633	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@40 psi	0.595	ASTM D5470	°C-in ² / W
Thermal impedance@50 psi	0.572	ASTM D5470	°C-in ² / W

Thermal Resistance vs. Pressure vs. Deflection

